## 主流蓝牙芯片设计厂商(2019)最新排名\_cornrn的博客-CSDN博客

近十年来,蓝牙应用越来越广泛,在音频、键鼠、物联网等领域越来越普及,在广东珠三角一带,更是聚集了上万家蓝牙产品制造厂商。目前全球蓝牙射频芯片厂家众多,在不同领域,各有所长,因此,终端厂商根据自身产品对蓝牙芯片的选型至关重要。小编在最近4个多月时间里,走访终端客户不下100家,对该行业经过慎重了解之后,针对不同细分市场,小编从品牌知名度、市占率、客户口碑及芯片使用体验对各家芯片厂商进行一次综合排名,希望能够给终端厂商对芯片的选型带来些许帮助,如有谬误,还望行业各位专家多多指正。

## 一、蓝牙音箱主流芯片厂商

- 1、**CSR**(总部:英国)
- 1)市场占有率:约15%左右;
- 2) 常用芯片型号:

CSR8615、CSR8635、CSR8645为4.1单模蓝牙。

CSR8670、CSR8675为5.0双模蓝牙。

3) 2018最新出的芯片:

QCC5100系列:QCC5120、QCC5121,均是5.0双模蓝牙。

QCC300x系列:QCC3001、QCC3002、QCC3003、QCC3004、QCC3005应用于蓝牙耳机,

QCC3006、QCC3007、 QCC3008用于蓝牙音箱,均是蓝牙5.0版本,双模蓝牙。

产品特点:

应用于纯蓝牙音箱市场,需外挂flash或EEPROM,支持独有的APTX无损格式蓝牙传输;性能稳定,功耗低,音质好,距离远;开发简单,没有对外开放SDK,只有PC端上位机工具,但也因此外围功能扩展受限,只能做纯蓝牙产品。

5) 市场定位及客户群体:

高端蓝牙音箱市场市场,大品牌音箱厂商。

- 2、珠海市杰理科技股份有限公司(总部:广东珠海)
- 1) 市场占有率:约40%左右;
- 2) 常用芯片型号:

690N系列:AC6901、AC6902、AC6905、AC6903等,均是4.2双模蓝牙;

3) 2018年最新推出的芯片:

**692N**系列:**AC6921、AC6922、AC6923、AC6925、AC6928**等,均是蓝牙**5.0**双模。

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、flash、FM、DSP等模块,支持U盘、SD卡、

AUX、混响等功能,功能齐全。对外开放SDK包,外围扩展接口丰富,用户可自行定义产品功能,调试方便。在中低端市场,音质、底噪、稳定性、功耗等方面,客户口碑不错,且每颗芯片都支持一拖二、TWS功能。

5) 市场定位及客户群体:

中低端蓝牙音箱市场,品牌厂商、品牌电商、礼品市场;

- 3、锐迪科微电子有限公司(总部:上海)
- 1) 市场占有率:约15%左右;
- 2) 常用产品型号:

RDA5856TE (TSSOP24) \cdot RDA5856TE (TSSOP28) \cdot RDA5856TE (QFN32)

均为4.2单模蓝牙。

3) 2018年最新推出的产品型号:

RDA5836SE (SOP16) \cdot RDA5836SE (TSSOP24) \cdot RDA5836SE (QFN40)

均为4.2单模蓝牙。

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、FLASH、FM等模块,支持U盘、SD卡、AUX等功能。对外开放SDK包,SDK包的系统框架相对复杂,工程开发比较麻烦,底噪稍大,多功能的方案难以开发,GPIO驱动电流小,推led屏还需外挂MCU,不能支持一拖二、TWS功能,因此,在公模市场使用的比较多。

5) 市场定位及客户群体:

中低端蓝牙音箱市场,礼品市场、PCBA厂商;

- 4、博通集成电路股份有限公司(总部:上海)
- 1)市场占有率:约13%左右;
- 2) 常用产品型号:

BK3254 (QFN32) \ BK3254 (SSOP28) \

均为4.2单模蓝牙

3) 2018年最新推出的产品型号:

BK3266 (SOP16)、BK3266 (TSSOP28)、BK3266 (QFN32)、BK3266 (QFN40) 均为4.2双模蓝牙;

4) 产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、FLASH、FM等模块,支持U盘、SD卡、AUX等功能。对外开放SDK包,SDK包的系统框架相对复杂,工程开发比较麻烦,底噪稍大,多功能的方案难以开发,GPIO驱动电流小,推led屏还需外挂MCU,只有3254X能支持一拖二、TWS功能,因此,大部分芯片在公模市场使用的比较多。

5) 市场定位及客户群体:

中低端蓝牙音箱市场,礼品市场、PCBA厂商;

5、卓荣集团(总部:香港)

- 1) 市场占有率:约7%左右;
- 2) 常用产品型号:

CW661X系列: CW6611D、CW6611F、CW6611C、CW6611E等;

CW66XX系列:CW6631A、CW6631B、CW6621E、CW6621C等;

CW6622系列:CW6622A、CW6622D、CW6622W;

均为3.0+EDR蓝牙

3) 2018年最新推出的产品型号:

暂无

4)产品特点:

对外开放SDK包,外围接口丰富,支持U盘、SD卡、AUX等功能,CW661X和CW66XX芯片需外挂flash、FM,集成度不高,外围物料偏多。只有6622系列是SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、FLASH、FM等模块,目前仅供部分客户使用。

5) 市场定位及客户群体:

中低端蓝牙音箱市场,礼品市场、PCBA厂商;

- 6、珠海炬力集成电路设计有限公司(总部:珠海)
- 1) 市场占有率:约4%左右;
- 2) 常用芯片型号:

ATS2805、ATS2823B、ATS2825B、ATS2825T、ATS2815、ATS2829等;

其中ATS2825、ATS2823B、ATS2829为是4.2双模蓝牙;

3) 2018年最新推出的芯片:

暂无

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、DSP等模块,外挂flash、FM。支持U盘、SD卡、AUX等功能,在中低端市场,音质比较好,客户口碑不错,但价格偏贵;

5) 市场定位及客户群体:

中低端蓝牙音箱市场,中小品牌厂商,电商;

- 二、蓝牙耳机主流芯片厂商
- 1、CSR(总部:英国)
- 1) 市场占有率:约20%左右;
- 2) 常用芯片型号:

CSR8615、CSR8635、CSR8645为4.1单模蓝牙。

CSR8670、CSR8675为5.0双模蓝牙。

3) 2018最新出的芯片:

QCC5100系列: QCC5120、QCC5121,均是5.0双模蓝牙。

QCC300x系列:QCC3001、QCC3002、QCC3003、QCC3004、QCC3005均5.0双模蓝牙。

4)产品特点:

应用于纯蓝牙耳机市场,需外挂flash或EEPROM,支持独有的APTX无损格式蓝牙传输;性能稳定,功耗低,音质好,距离远,客户口碑很好。

5)市场定位及客户群体:

高端蓝牙耳机市场,大品牌耳机厂商、电商;

- 2、络达科技股份有限公司(总部:台湾)
- 1)市场占有率:约7%左右;
- 2) 常用芯片型号:

AB1526、AB1522S、AB1523S、AB1511、AB1512、等

AB1522S \ AB1523S \ AB1526 \ AB1510G \ AB1511G \ AB1512G \ AB1513G ;

3) 2018最新出的芯片:

暂无

4) 产品特点:

应用于纯蓝牙耳机市场,功耗低,支持1托2功能,TWS功能,外挂EEPROM或者FLASH;开发简单,没有对外开放SDK,只有PC端上位机工具。

5) 市场定位及客户群体:

中高端蓝牙耳机市场,中高端品牌客户、电商;

- 3、创杰(总部:台湾)
- 1)市场占有率:约5%左右;
- 2) 常用芯片型号:

ISSC1681、ISSC1685、ISSC1684等,均为蓝牙3.0;

ISSC2008、ISSC2010、ISSC2020、ISSC2023;均为蓝牙4.1单模;

ISSC2063、ISSC2064、ISSC2062;均为蓝牙4.2;

3) 2018最新出的芯片:

暂无

4)产品特点:

应用于纯蓝牙音箱、耳机市场,需外挂flash或EEPROM,性能稳定,功耗低,音质好,距离远;支持1托2功能,开发简单,没有对外开放SDK,只有PC端上位机工具。

5) 市场定位及客户群体:

中高端蓝牙耳机市场,中高端品牌客户、电商;

- 4、珠海市杰理科技股份有限公司(总部:广东珠海)
- 1) 市场占有率:约30%左右;

2) 常用芯片型号:

AC6904、AC6907、AC6908、AC6903B等;均是4.2双模蓝牙;

3) 2018年最新推出的芯片:

AC691N系列:AC6911、AC6916、AC6919、AC6917等;均是5.0蓝牙双模。

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、flash、DSP、PMU等模块,支持1托2功能、TWS功能,功耗小、距离远、性能稳定。

5)市场定位及客户群体:

中低端蓝牙耳机市场,品牌厂商、电商、礼品市场;

- 5、博通集成电路股份有限公司(总部:上海)
- 1)市场占有率:约12%左右;
- 2) 常用产品型号:

BK3254(QFN32)、BK3260(QFN32)均为4.2单模蓝牙;

3) 2018年最新推出的产品型号:

BK3266(SOP16)、BK3266(QFN32)、BK3266(QFN40)均为4.2双模蓝牙;

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、FLASH、PMU等模块,底噪稍大,距离远、性能稳定。

5)市场定位及客户群体:

中低端蓝牙耳机市场,礼品市场;

- 6、恒炫科技有限公司(风洞)(总部:上海)
- 1) 市场占有率:约8%左右;
- 2) 常用芯片型号:

BES系列:BES2000L、BES2000T、BES2000S等;均为4.2蓝牙双模;

WT系列:WT200M、WT200S、WT200T等均是4.2双模蓝牙;

3) 2018年最新推出的芯片:

暂无

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,

恒玄(BES):功耗小、音质好,主推降噪中高端耳机;

风洞(WT):功耗小、主推TWS中低端耳机;

5) 市场定位及客户群体:

恒玄:中高端蓝牙耳机市场;

风洞:中低端蓝牙耳机市场。

- 9、锐迪科微电子有限公司(总部:上海)
- 1) 市场占有率:约5%左右;
- 2) 常用产品型号:

无;

3) 2018年最新推出的产品型号:

RDA5836SE (SOP16) \ RDA5836SE (QFN40) ;

均为4.2单模蓝牙。

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,内部集成MCU、FLASH、PMU等模块,底噪稍大,距离正常。

5)市场定位及客户群体:

中低端蓝牙耳机市场,礼品市场;

- 10、卓荣集团(总部:香港)
- 1) 市场占有率:约5%左右;
- 2) 常用产品型号:

CW6691D、CW6686B、CW6687B、CW6676H、CW6686H等均为3.0单模蓝牙

3) 2018年最新推出的产品型号:

暂无

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片,CW6691D、CW6686B、CW6687B内部集成MCU、FLASH、PMU等模块,功耗稍大,距离稳定性调试麻烦。

5) 市场定位及客户群体:

中低端蓝牙音箱市场,礼品市场、PCBA厂商;

- **11、中星微:**(总部:北京)
- 1)市场占有率:约1%左右;
- 2) 常用产品型号:

WS9621、WS96623、WS96626等,均为4.1单模蓝牙;

3) 2018年最新推出的产品型号:

暂无

4)产品特点:

应用于纯蓝牙耳机市场,外挂EEPROM或者FLASH,功耗低,支持1托2功能;

5) 市场定位及客户群体:

中端蓝牙耳机市场;

12、富瑞坤(总部:上海)

1)市场占有率:约1%左右;

2) 常用产品型号:

FR3011、FR3016、FR3019等

3) 2018年最新推出的产品型号:

FR3020等;

4)产品特点:

SOC多合一蓝牙芯片

5)市场定位及客户群体:

低端蓝牙耳机市场、礼品市场;

三、纯BLE数传产品的主流芯片厂商

1、NORDIC(总部:挪威)

常用芯片型号:

nRF52840, nRF52832, nRF52810, nRF51822,

nRF51824, nRF51422

产品特点:

nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,适用于Bluetooth低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式Nordic nRF24L系列产品无线兼容。支持 S110 蓝牙低功耗协议 堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。主要运用于移动电话配件、PC周边产品/玩具和电子游戏、智能家居设备等领域。淘宝、博客等地方最该芯片的使用及解决方案也比较多,比较适合蓝牙入门学习者。

- 2、TI德州仪器 (总部:美国)
- 1) 常用芯片型号:

CC2540、CC2541、CC2640、CC2652、CC2642等;

2) 2018年最新推出的芯片:

暂无

3)产品特点:

TI可以支持BT4.1及以上的协议栈,也是业界唯一以ARM Cortex-M3+M0+16bit协处理器为核心架构的SOC芯片。TI提供完整的参考设计,不需要太多RF专业知识也能轻易发开,使得开发门槛降低。支持空中升级(OTA)功能。可以应用于智能家居、玩具等领域。TI的这款芯片在国内网上的资源非常多,且国内专门做TI芯片解决方案的公比较多,所以很适合自学蓝牙开发,开发过程中遇到的很多问题都基本能解决。

3、**Dialog**(总部:德国)

常用芯片型号:

## DA14580、DA14681、DA14585等;

产品特点:

软件开发难度大,有单价优势,功耗低。

4、笙科(总部:台湾)

常用芯片型号: A8107M0;

**5、赛普拉斯**(总部:美国)

常用芯片型号:CYW20706、CYW20737、CYW20736等;

**6、CSR**(总部:英国)

常用芯片型号:

CSR102x系列: CSR1020、CSR1021、CSR1024、CSR1025

均为蓝牙4.2版本。

产品特点:

英国CSR公司的CSR101x系列采用蓝牙4.0技术,是一款单模蓝牙低功耗平台,提供CSR uEnergy SDK2.5.1开发环境。CSR市场占有率高,受欧美市场的欢迎和认可,但是价格居高不下,一般的供应商也不会选择这种产品。可用于智能蓝牙语音遥控器、智能家居等。目前针对这款芯片国内网站上的资源相对来说比较少一些。

7、泰凌微(总部:上海)

常用产品型号:

TLSR8263 \ TLSR8267 \ TLSR8267F512 ;

TLSR8266 \ TLSR8266F512 ;

8、博通集成电路股份有限公司(总部:上海)

常用芯片型号:

BK3431、BK3231等; 蓝牙4.0单模;

产品特点:

BK3431芯片是高度集成的蓝牙4.0低功耗单模设备。它集成了一个高性能RF收发器,基带,ARM内核微处理器,丰富的功能外设单元,可编程协议和配置文件,以支持BLE应用。闪存程序存储器使其适用于定制应用程序。开发成本低,但是芯片本身的软件有一定的bug,开发起来比较费时。

9、珠海市杰理科技股份有限公司(总部:广东珠海)

常用芯片型号:

AC6919B等;

10、昆天科微电子技术有限公司(总部:北京)

常用芯片型号:

QN9021、QN9022等

1、CSR/高通(被高通收购)

【总部】:英国/美国

【蓝牙芯片型号及其简介】:

CSR101x芯片组产品系列:包括CSR1010,CSR1011,CSR1012,CSR1013,蓝牙4.1,低功耗蓝牙,CSRmesh技术。单芯片Qualcomm®Bluetooth®LowEnergy无线电,集成了微处理器和增强型存储器,可提供卓越的应用灵活性。

CSR102x产品系列:包括CSR1020、CSR1021、CSR1024、CSR1025,蓝牙4.2,低功耗蓝牙,CSRmesh技术。CSR102x芯片组产品系列针对物联网中的特定应用进行了优化,包括无线遥控器,简易智能手表,家庭自动化解决方案以及平衡性能,电池寿命和价格点至关重要的信标。

QCC300X产品系列:包括QCC3001、QCC3002、QCC3003、QCC3004、QCC3005、QCC3006 QCC3007 QCC3008,蓝牙5.0,双模蓝牙。其中QCC3001、QCC3002、QCC3003、QCC3004、QCC3005应用于蓝牙耳机,QCC3006 QCC3007 QCC3008应用于蓝牙音箱。

QCC5100系列:包括QCC5120、QCC5121系列,蓝牙5.0,超低功耗,高级SoC,用于紧凑,功能丰富的无线耳塞,可编程和耳机。

QCA4024: QCA4024 SoC是一款双模片上系统,支持基于蓝牙5.0和802.15.4的技术,包括Zigbee和Thread。

QCA4020: QCA4020 SoC是一款三模片上系统,支持双频WIFI,基于蓝牙5.0和802.15.4的技术,包括Zigbee和Thread。

CSRB53xx系列:包括CSRB5341、CSRB5342、CSRB5348,都是蓝牙4.1版本,双模蓝牙。

CSRA68100: CSRA68100是蓝牙音频平台,可在蓝牙扬声器和耳机市场的顶级终端实现创新和功能差异化。它的DSP处理能力比以前的高级蓝牙SoC CSR8675多4倍,并且在单芯片平台上具有高级功能,支持便携式无线扬声器和具有卓越音频质量,语音控制,远场回声消除,传感器的耳机的开发处理和音频后期处理。蓝牙5.0版本。

**CSRA65700**: **CSRA65700**是低音炮**ROM**解决方案,蓝牙**4.0**版本。

CSR8811:CSR8811芯片组用于消费电子设备的蓝牙v4.1单芯片无线电和基带IC。蓝牙低功耗,CSRmesh技术,双模蓝牙。

CSR86xx系列:包括CSR8605、CSR8610、CSR8615、CSR8620、CSR8630、CSR8635、CSR8645这些都是蓝牙4.1版本,CSR8670、CSR8675是蓝牙5.0版本。

CSR8510: CSR8510蓝牙4.0版本,双模蓝牙。

CSR8350: CSR8350、CSR835A都是蓝牙4.1版本,双模蓝牙。

CSR8311: CSR8311蓝牙4.1版本,双模蓝牙。

QCA9379:QCA9379 Wi-Fi /蓝牙SoC,结合了先进的2x2双频802.11ac MU-MIMO Wi-Fi +蓝牙4.2,采用高性能,小尺寸设计。

QCC3026:QCCC3026是一款基于超低功耗架构的入门级闪存可编程蓝牙音频SoC,蓝牙5.0,专为紧凑型功能优化的Qualcomm TrueWireless™耳塞而设计。QCC3026 旨在为我们的客户提供有助于缩短开发时间并具有成本效益的解决方案。

【官网】: http://www.csr.com/

2、德州仪器(TI)

【总部】:美国

【蓝牙芯片型号及其简介】:

CC2642R: 蓝牙5.0版本。

CC2652R: 蓝牙5.0版本,蓝牙, Zigbee,线程, 2.4 GHz专有。

CC2640R2F-Q1:符合汽车标准的SimpleLink低功耗蓝牙无线MCU,蓝牙5.0版本。

CC2640R2F:SimpleLink蓝牙低功耗无线MCU,蓝牙5.0版本。

CC2564C:采用mrQFN封装的双模蓝牙控制器,经典蓝牙,双模蓝牙,蓝牙4.2。

CC2640:针对蓝牙智能应用的SimpleLink超低功耗无线MCU,蓝牙4.2。

CC2540T: 2.4GHz蓝牙低功耗无线MCU。

CC2541:无线MCU,蓝牙4.0。

CC2564:蓝牙Smart Ready控制器,智能RF收发器,蓝牙智能(蓝牙低功耗),经

典蓝牙,双模蓝牙。

CC2540:具有USB的SimpleLink蓝牙智能无线MCU,蓝牙智能(蓝牙低功耗)。

CC2560:蓝牙Smart Ready控制器,智能RF收发器。

【官网】: http://www.ti.com.cn/

3、赛普拉斯Cypress(收购Broadcom无线业务)

【总部】:美国

【蓝牙芯片型号及其简介】:

CYW20706: 蓝牙4.2 BR + EDR + BLE。

CYW20737: 蓝牙4.1 BLE。

CYW20736: 蓝牙4.1 BLE。

••••

【官网】: http://china.cypress.com/

4 · Nordic

【总部】:挪威

【蓝牙芯片型号及其简介】:

nRF52840:多协议蓝牙5.0/蓝牙低功耗/ANT/802.15.4/2.4GHz RF SoC。

nRF52832:多协议蓝牙5.0/蓝牙低功耗/ANT/2.4GHz SoC。

nRF52810:多协议蓝牙5.0/蓝牙低功耗/ANT/2.4GHz SoC。

nRF51822:蓝牙低功耗和2.4GHz专有多协议SoC。

nRF51824:汽车级蓝牙低功耗SoC。

nRF51422:ANT和ANT/蓝牙低功耗多协议SoC。

....

【官网】: http://www.nordicsemi.com/

5、意法半导体(ST)

【总部】:瑞士

【蓝牙芯片型号及其简介】:

BlueNRG-1:BlueNRG-1基于32MHz 32位ARM®Cortex®-M0的单核SoC使您能够在延长电池寿命的同时打造蓝牙智能应用,从而最大限度地降低总体成本并缩短产品上市时间。它符合BLE规范v4.2和嵌入式AES-128和ECC-256加密引擎,可实现一流的安全性和隐私性。BlueNRG-1采用QFN-32或WLCSP-34封装。蓝牙4.2。

BlueNRG-2:BlueNRG-2是新一代蓝牙低功耗(BLE)片上系统,具有大容量集成的256 KB闪存,可扩展的GPIO引脚和高达105°C的工作温度。该BlueNRG-2配备两个QFN-32和新QFN48封装,提供26个GPIO以及更灵活地添加传感器和发挥低功耗蓝牙连接。蓝牙5.0。

【官网】: https://www.st.com

6、东芝(Toshiba)

【总部】: 日本

【蓝牙芯片型号及其简介】:

TC35678:TC35678FXG和TC35678FSG均整合有内建快闪存储器,用于储存使用者程序和独立操作中的各种资料。尽管之前产品中使用者程序的存储器容量仅为64KB,但是在这两款IC中,这一容量均扩充至100KB,有助于促进应用程序的延展性。

TC35679FSG: TC35679FSG没有内建快闪存储器,其透过降低存取快闪存储器的电流消耗,可以实现极低的工作电流。因此,它支援由小型钮扣电池供电的应用实现较长的工作时间。例如,如果使用CR2032型钮扣电池,新的IC可以作为信标工作1年以上。

TC3567CFSG:TC3567CFSG集成了128KB闪速存储器,用于存储用户程序和独立操作中的各种数据并且可以执行最大50KB左右的应用程序。与之前产品一样,新IC为时钟发生器集成了射频匹配电路和晶体负载电容,在IC设计阶段可减少外部元器件数量,在最少情况下,元器件数量可少至七个。这有助于降低成本,缩小安装面积。

TC3567DFSG: TC3567DFSG没有内置闪速存储器,其通过降低访问闪速存储器的电流消耗,实现极低的工作电流。因此,它支持由小型钮扣电池供电的应用实现较长的工作时间。例如,如果使用CR2032型钮扣电池,该新IC可以执行信标操作长达2年以上。

TC35680FSG: TC35680FSG配置有用于存储用户程序和独立操作中的各种数据的 128KB闪存,因此适用于各种不同应用,而且在独立操作中不需要外部非易失性存储器。因而有助于减少元器件数量,降低成本,缩小安装面积。

TC35681FSG: TC35681FSG未配置内置闪存,需与外部非易失性存储器或主机处理器配合使用。该产品支持- $40^{\circ}$ 至 + $125^{\circ}$ C的宽工作温度范围,因此非常适合于存在高温的应用场合。

【官网】: http://www.toshiba.com.cn/

7、戴乐格半导体(Dialog)

【总部】:德国

【蓝牙芯片型号及其简介】:

DA14580被小米手环选用。DA14580是全球尺寸最小、功耗最低、集成度最高的蓝牙智能SoC。

【官网】: http://www.dialog-semiconductor.com/

8、创杰(ISSC)(被微芯收购)

【总部】:台湾

【蓝牙芯片型号及其简介】:

型号	蓝牙版本	数据经典.数 据/SPP	数据经典 <b>.音</b> 频	蓝牙低功 耗	音频频道
ATBTLC1000	4.1	没有	没有	是	没有
ATSAMB11	4. 1	没有	没有	是	没有
IS1677	3.0 / 4.0 + EDR	是	没有	是	没有
IS1678	4. 2	是	没有	是	没有
IS1690	3.0 + EDR	没有	是	没有	立体声
IS1870	4. 2	没有	没有	是	没有
IS1871	4. 2	没有	没有	是	没有
IS2008	4.1 + EDR	没有	是	没有	单
IS2010	4.1 + EDR	是	是	没有	单
IS2013	4.1 + EDR	没有	是	没有	单
IS2015	4.1 + EDR	是	是	没有	单
IS2020	4.1 + EDR	是	是	没有	立体声
IS2021	4.1 + EDR	是	是	没有	立体声
IS2022	4.1 + EDR	是	是	没有	立体声
IS2023	4.1 + EDR	是	是	没有	立体声
IS2025	4.1 + EDR	是	是	没有	立体声
IS2062	4. 2	是	是	是	立体声
IS2063	4. 2	没有	是	是	立体声
IS2064	4. 2	是	是	是	立体声

【官网】: http://www.issc-tech.com/

说明:微芯科技也有生产蓝牙模块。

9、炬力集成电路设计有限公司

【总部】:珠海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

ATS2829: 蓝牙音频解决方案Soc, 蓝牙4.2, 并支持双模(BR/EDR + AMP + Low **Energy Controllers**) •

ATS2825: 蓝牙音频解决方案Soc, 蓝牙4.2, 并支持双模(BR/EDR + AMP + Low

Energy Controllers) •

ATS2823:蓝牙音频解决方案Soc,蓝牙4.2。

M-ATS2805BA: 蓝牙V4.0双模模块。

ATS3503:集成蓝牙收发器、丰富功能的基带处理器和蓝牙音频文件。蓝牙控制器 V4.2兼容4.1 / 4.0 / 2.1 + EDR。支持蓝牙双模(BR / EDR),BR / EDR和LE可同时连接。

•••••

【官网】: http://www.actions-semi.com/

10、昆天科微电子技术有限公司(Quintic)

【总部】:北京

【主营】:是一家业界领先的芯片设计公司,专注于给众多消费类市场和客户提供低能耗、高精度、高性价比的无线接入集成电路设计、开发及解决方案。

备注:恩智浦收购昆天科旗下可穿戴式和蓝牙低功耗芯片业务。

11 · RDA

【总部】:上海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

MCU蓝牙

RDA5851S: 蓝牙2.1+EDR

RDA5856TE: 蓝牙4.2+EDR

RDA5856LE:蓝牙4.2+EDR标准+BLE

RDA5856QE32: 蓝牙4.2+EDR标准+BLE

RDA5871: 蓝牙2.1

HCI蓝牙

RDA5875Y: 蓝牙2.1+EDR

RDA5876: 蓝牙2.1+EDR

RDA5876A: 蓝牙2.1+EDR

【官网】: http://www.rdamicro.com/

12、安凯微电子

【总部】:广州

【蓝牙芯片型号及其简介】:

AK10D系列芯片: 2017年12月28日,安凯微电子推出智能蓝牙5.0双模立体声音频芯片AK10D系列芯片及解决方案。目前,这款芯片已支持百度度秘语音助手平台。

【官网】: http://www.anyka.com/

13、卓荣集团

【总部】:香港

【蓝牙芯片型号及其简介】:

CW6690G:HIFI高端蓝牙音频主控芯片。内置高性能DSP和双模蓝牙,采用32bit RISC CPU+ DSP灵活高效架构。集成了高保真HIFI品质全格式解码与立体声模拟数字转换电路,以及高性能音频数字处理能力。广泛适用于各种高端音频设备产品。支持蓝牙4.0、蓝牙2.1+EDR双模蓝牙协议。

CW6676X:一系列高性能低功耗的BT+MP3的单芯片,集成了优越的模拟和数字外设,实现蓝牙音乐的播放、语音通讯及手机拍照控制等各种蓝牙应用。经典蓝牙4.2,向下兼容蓝牙3.0/2.1+EDR。

CW6611X:一系列高性能低功耗的BT+MP3的单芯片,集成了优越的模拟和数字外设,实现蓝牙音乐的播放、语音通讯及手机拍照控制等各种蓝牙应用。采用Bluetooth V4.2 classic规范,兼容蓝牙3.0及以下版本。

CW6687B/8B: 为高性能低功耗的BT+MP3的蓝牙耳机专用芯片,支持蓝牙4.2技术规范;其中CW6687B/88B支持集成充电管理及回音消除功能,适用于定制更高性能的耳机方案。

【官网】:http://www.buildwin.com.cn/

14 · MTK

【总部】:台湾

【蓝牙芯片型号及其简介】:

MT7622:作为全球首款蓝牙5.0规格的系统单芯片(SOC),主频为1.35GHz的64位 双核ARM Cortex-A53处理器。MT7622内建联发科技独家Wi-Fi网络加速器技术,实现优质的网络连接体验。另外,MT7622支持主流必备的音频接口,包括I2S、TDM和S/PDIF。另外,该芯片除了同时整合Wi-Fi、蓝牙和Zigbee,还提供了一系列丰富的慢速输入/输出端口,以满足家用自动网关的技术需求。

【官网】: https://www.mediatek.tw/

15、络达科技股份有限公司

【总部】:台湾

【蓝牙芯片型号及其简介】:

AB1526:一款先进的单芯片解决方案,集成了用于高密度音频应用的基带和收音机。AB1526支持蓝牙4.2双模认证,它内嵌串行闪存,更灵活的客户软件升级和支持第三方软件移植。

【官网】: http://www.airoha.com/

16、山景集成电路

【总部】:上海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

BM5064型号芯片仅用于特定蓝牙模组生产使用,芯片不单独销售。

【官网】:http://www.mvsilicon.com/

17、珠海市杰理科技有限公司

【总部】:珠海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

AC410N:AC410N系列是一款蓝牙音响系列芯片,具有96KB SRAM的低功耗,高性能微处理器,集成了32位RISC CPU和丰富的外围电路。这个系列的特点事但芯片,

推出的目的是为了低功耗应用,蓝牙版本为2.0+EDR。

【官网】: http://www.zh-jieli.com/

18、上海博通

【总部】:上海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

BK3431:是一款高度集成的蓝牙4.0低功耗单模设备。它集成了高性能RF收发器,基带,ARM内核微处理器,丰富的功能外设单元,可编程协议和配置文件,以支持BLE应用。闪存程序存储器使其适用于定制应用程序。

BK3231:是一款高度集成的单芯片Bluetooth3.0HID器件。它集成了高性能收发器,丰富的功能基带处理器和蓝牙HID配置文件。FLASH程序存储器使其适用于定制应用程序,也可用于其他蓝牙应用程序,如SPP控制器。

BK3260:是一款蓝牙4.0双模音频设备,集成了14443-A NFC卡。它集成了RF收发器,功能丰富的基带处理器,FLASH存储器控制器,多个模拟和数字外设以及包括音频和免提配置文件的蓝牙软件堆栈。

BK3254:是高度集成的单芯片蓝牙4.1多媒体设备。它集成了蓝牙收发器,FM接收器,SD卡接口,USB OTG和高性能音频外设。基于BK3254缓存的架构使其可以在任何应用中完全编程,可用于控制和多媒体混合应用。

BK8000: 是一颗高集成度的蓝牙2.1+EDR音频单芯片。该芯片集成了高性能蓝牙收发器、多功能基带处理器和蓝牙音频协议。

BK3252:是一颗高集成度的单芯片蓝牙2.1+EDR多媒体器件。该芯片集成了蓝牙收发器、FM接收器和高性能音频外设。

BK8002:是一颗高集成度的单芯片蓝牙2.1+EDR多媒体器件。该芯片集成了蓝牙收发器、FM接收器和高性能音频外设。

BK8000L:是一颗高集成度的蓝牙2.1+EDR音频单芯片。该芯片集成了高性能蓝牙收发器、多功能基带处理器和蓝牙音频协议。

. . . . .

【官网】: http://www.bekencorp.com/

19、上海巨微集成电路有限公司

【总部】:上海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

MG127、MG126、MS1591、MS1793等低功耗蓝牙数传芯片。

【官网】: http://www.macrogiga.com/

20、深圳市伦茨科技有限公司

【总部】:深圳

【蓝牙芯片型号及其简介】:

ST17H26ES16、ST17H30ET24、ST17H29ES16、ST17H38ET48: 蓝牙4.2, 应用在防丢器、智能灯/群控灯、电子秤、ibeacon、触摸游戏VR手柄/游戏手柄、智能锁、情趣用品以及其他智能家居物联网产品上。

ST17H25ET32:蓝牙4.2,应用手环、手表、蓝牙MESH灯/组网灯以及其他MESH组

网应用。

【官网】: http://www.lenzetech.com/

21、泰凌微电子(上海)有限公司

【总部】:上海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

TLSR8263: 低成本BLE + 2.4G双模式芯片

TLSR8267/TLSR8267F512: 蓝牙4.2低功耗(BLE) 芯片。

TLSR8266/TLSR8266F512: 蓝牙 SoC, 符合蓝牙4.0标准。

【官网】: http://cn.telink-semi.com/

22、恒玄科技(上海)有限公司

【总部】:上海

【蓝牙芯片型号及其简介】:

BES2000L/T/S:BES2000L/T/S系列适用于各种蓝牙耳机,蓝牙音箱产品开发。采用先进的低功耗CMOS技术,支持蓝牙双模2.1+4.2,集成高品质Codec及功放,高性能Cortex-M4F MCU,同时集成了FLASH,方便客户进行定制软件优化。部分耳机产品芯片支持主动降噪(ANC)功能。

BES2000U/A:BES2000U/A系列适用于各种无线双耳和无线对箱产品开发。采用先进的低功耗CMOS技术,具有完全自主专利的FWS技术,支持蓝牙双模2.1+4.2,集成高品质Codec及功放,高性能Cortex-M4F MCU,同时集成了FLASH,方便客户进行定制软件优化。

BES3101S:BES3100S/BES3101S系列产品适用于各种Type-C耳机产品的开发,支持USB2.0FS/HS,部分芯片型号支持业界领先的数字前馈及反馈主动降噪技术。

23、瑞昱半导体(Realtek)

【总部】:台湾

【蓝牙芯片型号及其简介】:

RTL8762A: 蓝牙低功耗SOC

RTL8761ATV: 蓝牙2.1 / 3.0 / 4.0控制器, UART接口

RTL8761AUV: 蓝牙2.1 / 3.0 / 4.0控制器, USB接口